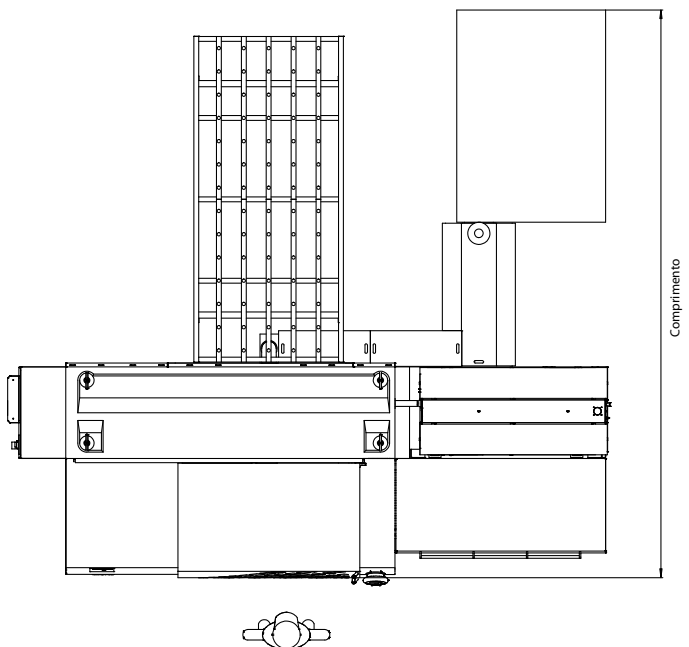
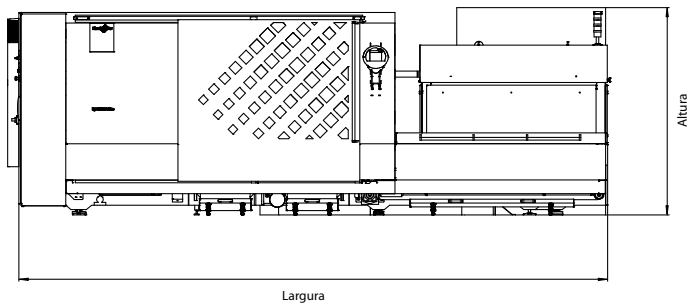


Dados técnicos

ByVention 3015

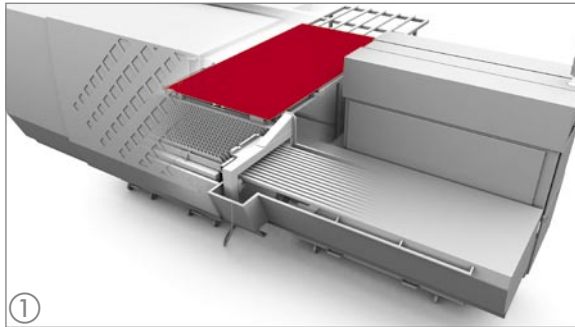


ByVention 3015

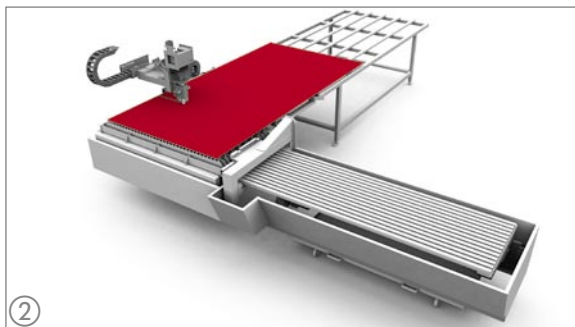
Capacidade de laser	2200 W	4400 W
Comprimento	6000 mm	6000 mm
Largura	6000 mm	6400 mm
Altura	2150 mm	2150 mm

Conceito inovador de movimentação de materiais

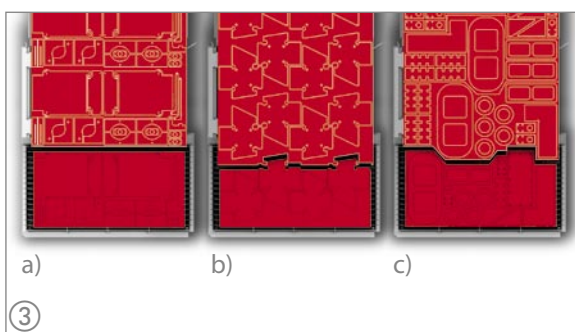
A ByVention é o menor equipamento de corte a laser para formatos de chapas padronizadas. Devido ao seu projeto inovador e inteligente de movimentação de material, as peças acabadas são transportadas contínua e automaticamente para fora da região de corte. Essas peças já estarão à disposição do usuário durante o processo de corte. A retirada das peças é simples e conveniente. A região da retirada possui o acesso aberto.



A placa de chapa é colocada manualmente na mesa de carregamento e empurrada para o encosto da mesa.



A chapa é puxada automaticamente para a região de corte. As peças dentro do primeiro segmento serão cortadas.



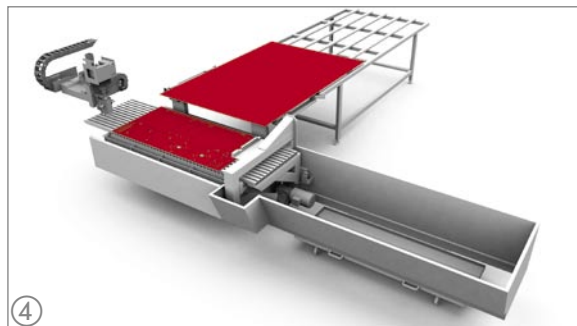
Na ByVention, as chapas são divididas em segmentos processados uns após os outros. A partir desse ponto, existem **três** estratégias diferentes para intercalar as peças na chapa.

a) Estratégia sem sobreposição

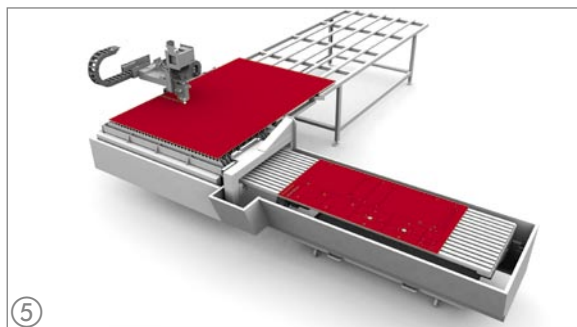
Essa estratégia é adequada para peças que podem ser inseridas de uma forma otimizada dentro de um retângulo. Antes que as peças sejam cortadas, o segmento será separado com um corte reto. O comprimento máximo do segmento corresponde a 772 milímetros da região de corte.

b) Estratégia com sobreposição e corte divisório parcial

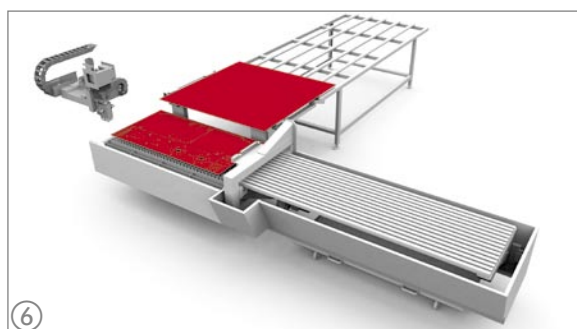
Essa estratégia maximiza o aproveitamento da chapa, quando as peças não puderem ser intercaladas de forma otimizada dentro de um retângulo. O corte de separação coincide parcialmente com os contornos externos das peças e não transcorre mais de forma reta. Os segmentos são travados entre si. As peças de um segmento se encontram todas dentro da região de segmento de 772 a 1562 milímetros.



O próximo segmento de chapa que teve o processamento concluído é posicionado automaticamente na mesa de retirada.



A mesa de retirada conduz automaticamente o segmento de chapa que teve seu processamento concluído da região de corte para a região de retirada. Simultaneamente o restante da chapa é puxado para a região de corte para que o próximo segmento possa ser cortado. As peças cortadas, assim como as sobras, são então removidas manualmente da região de descarga.



O segmento de chapa que teve o processamento concluído é posicionado automaticamente na mesa de descarga. Essa seqüência se repete até que toda a chapa seja processada. Assim que o último segmento da chapa alcançar a região de corte, uma nova chapa pode ser colocada na mesa de carregamento.

O software de corte e dobra Bysoft da Bystronic apóia os processos da ByVention de forma otimizada e, conforme a necessidade, é possível selecionar automaticamente na programação a estratégia otimizada para a segmentação da chapa.

c) Estratégia com sobreposição e corte divisório total

Essa estratégia pode ser utilizada alternativamente à estratégia b), principalmente em espessuras de chapa a partir de 3 milímetros, peças com geometrias complexas ou quando muitas peças se encontram na zona de sobreposição. Em contraste com a estratégia b) aqui ocorre um corte divisório total, que evolui em uma distância definida ao longo dos contornos da peça. Apresenta as seguintes vantagens:

1. as ranhuras devem ser abertas somente uma vez, significando economia de tempo, principalmente, em chapas espessas
2. a máxima segurança do processo é também assegurada em peças complexas, engavetamentos e espessuras maiores de chapa.

Capacidade de laser	2200 W	4400 W
Tamanho nominal da chapa (comprimento x largura)	3000 x 1500 mm	3000 x 1500 mm
	2500 x 1250 mm	2500 x 1250 mm
	2000 x 1000 mm	2000 x 1000 mm
Faixa de corte	x = 1562 mm	x = 1562 mm
	y = 772 mm	y = 772 mm
	z = 100 mm	z = 100 mm
Velocidade máx. paralela do eixo x/y	100 m/min	100 m/min
Velocidade máx. simultânea do eixo x/y	140 m/min	140 m/min
Precisão de posicionamento Pa *	± 0,1 mm	± 0,1 mm
Repetibilidade Ps *	± 0,05 mm	± 0,05 mm
Peso da máquina **	13 500 kg	14 600 kg
Base	piso industrial reforçado e normal conforme plano de instalação	
Cabeçote de corte 5"	inclusive	inclusive
Cabeçote de corte 7,5"	opcional	inclusive
Consumo de gás de corte	dependente do material	
Acionamento	painel de controle com «touchscreen»	
Drives	interface USB 1.1 no aparelho de operação	
Conexão à rede	conexão RJ45 10/100 MBit/s	
ByVision (Especificações vide folha de dados)	opcional	opcional

Fonte a laser CO ₂	ByLaser 2200	ByLaser 4400
Potência	2200 W	4400 W
Comprimento de onda	10,6 µm	10,6 µm
Polarização	circular	circular
Frequência de pulso	1–2500 Hz	1–2500 Hz
Espessuras máximas da chapa ***		
Aço carbono	8 mm	8 mm
Aço inoxidável	6 mm	8 mm
Alumínio	4 mm	8 mm
Consumo elétrico do equipamento total ****	35 kW	54 kW

* Conforme VDI/DGQ 3441, comprimento de medição 1 m. A precisão da chapa depende do tipo do material e seu pré-tratamento, assim como da dimensão da chapa e do aquecimento.

** Equipamento completo de corte a laser sem unidade combinada de refrigeração e filtragem

*** Para cortar as espessuras máximas, devem ser atendidas as seguintes condições:

- Equipamento para corte a laser com manutenção e ajustes ideais
- Os materiais devem atender às qualidades exigidas pela Bystronic (materiais para laser)

**** Consumo típico incluindo unidade combinada de refrigeração e filtragem

Reservamo-nos o direito de efetuar alterações dimensionais, construtivas e de equipamentos. Com certificação ISO 9001

Seu contato

www.bystronic.com